

Laserssel

Laser Solution Platform

Beam Shaping Optic Module BSOM

- 다양한 Beam Size 출력이 가능한 Optic system
90% 이상의 높은 Uniformity 구현
- Output Power(continuous) : 16kW
 - Power Stability : $\pm 1\%$
 - Beam Size Range : 4 to 45



Laser Selective Reflow LSR

- 침판 반도체, 전기차 부품, SMT 접합이 가능한
면 레이저 리플로우 장비
High speed, No warpage
- PCB Size : 240 x 80 mm / 300 x 300 mm
 - Beam Size(Optic) : 80 x 80mm ~ 300 x 300mm (Variable)
 - Laser Power : 2~12kW



Rework Laser Selective Reflow rLSR

- Mini / Micro LED의 불량 LED를 detach 하는 장비
LED rework without damage on LED / PCB
- PCB Size : Max 400 x 700 mm (include carrier)
 - Beam Size(Optic) : 100 x 300 um
 - Laser Power : 30 ~ 200W



INnovation Bonding Optical Laser NBOL

- 냉각 시스템 일체형 Laser 모듈
차세대 고효율 멀티코어 레이저 시스템
- Ambient temperature : $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
 - Stability : $\pm 0.1 \sim 0.3^{\circ}\text{C}$
 - Power consumption : 5.6 kW / 8.5kW

Laser Compression Bonder LCB

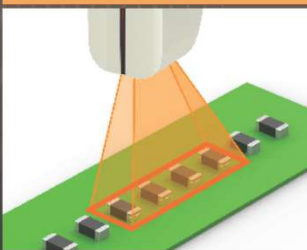
- 침판반도체 전용 면레이저 가압 본딩 장비
Warpage Free Reflow
- PCB Size : 100 x 100 mm
 - Compression Area : 100 x 100 mm
 - Beam Size(Optic) : 20 x 120mm
 - Laser Power : 16kW



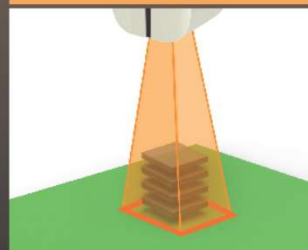
Laserssel
GLOBAL NO.1
LASER SOLUTION PLATFORM

Area Laser Bonding Applications

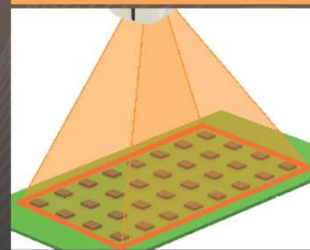
Multi Component



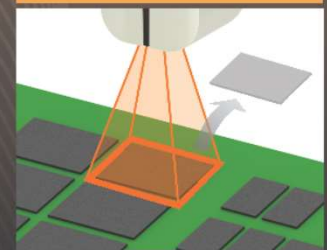
Stacking Die



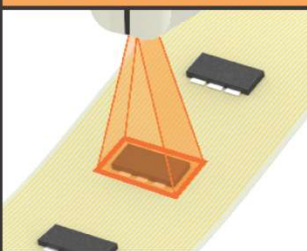
Whole PCB Reflow



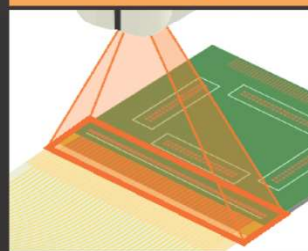
BGA Rework



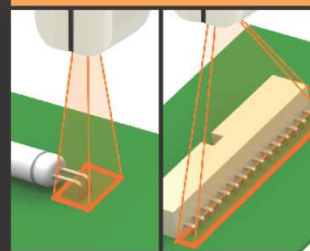
Component on Film



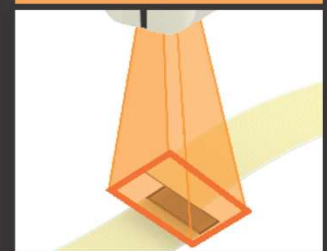
FPCB + Rigid



Via Hole(Capacitor, Connector)



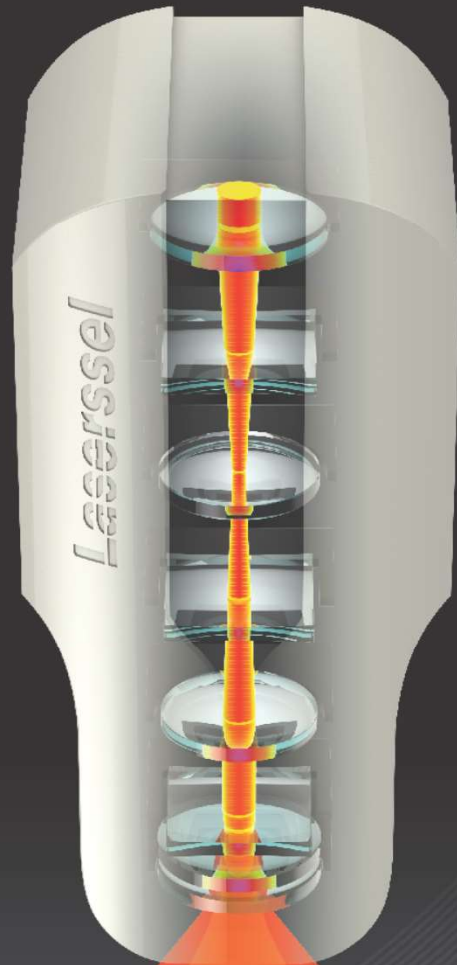
FPCB + FPCB



Laserssel

World First & Only
Area Laser & Optic system

Global No.1 Area Laser Solution Platform



7月デモ機を導入予定です
お気軽にお問い合わせ下さい



<https://www.nadex.co.jp/>

- | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| ● 国内拠点 | 本社 | 〒460-8338 | 愛知県名古屋市中区古渡町9番27号 | TEL:052-322-3511 | FAX:052-332-4324 |
| | 技術センター | 〒481-0038 | 愛知県北名古屋市徳重御宮前1 | TEL:0568-21-1428 | FAX:0568-23-5540 |
| | 東部営業部 | 〒330-0802 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1KDX大宮ビル4階 | TEL:048-650-7181 | FAX:048-650-7182 |
| | 横浜営業所 | 〒222-0033 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-8KDX新横浜ビル3階 | TEL:045-270-0534 | FAX:045-270-1659 |
| | 西部営業部 | 〒532-0011 | 大阪府大阪市淀川区 西中島4丁目1番1号日清食品ビル10階 | TEL:06-6305-0525 | FAX:06-6305-5556 |
| | 京都開発センター | 〒600-8177 | 京都府京都市下京区烏丸通り五条下ル大坂町396番地キョートビル7階 | TEL:075-278-7805 | FAX:075-278-7806 |
| ● その他拠点 | 山形、太田、浜松、福井、 | 広島、北九州 | | | |
| ● 海外拠点 | ○米国 / ミシガン州 | ○メキシコ / ケレタロ州 | ○中国 / 上海、広州、天津、武漢、長春 | ○タイ / バンコク | ○インドネシア / チカラン V1.0 |